AIT 产品应用分析和需求表

QOF-7.2-1 Rev. F 6/6/13 © AI Technology, Inc., All rights reserved.

I. 客户信息　　**日期:**　　**AIT 联系人:**

姓名:	公司名称:
地址:	
联系方式:	Email:

II. 应用类别目录 *(请在如下应用中打√)*		***请在相应项中打 ✓，只能选一项***
(尽可能使用草图)	**1. 芯片粘接:** 胶水☐ 胶膜☐	导电?☐ 绝缘?☐ 倒装芯片焊接替代?☐
	2. 元件粘接: 胶水☐ 胶膜☐	仅机械固定?☐ 焊接替代?☐
	3. 底部填充: 胶水☐ 胶膜☐	倒装芯片导热机械固定?☐ 元件的导热机械固定?☐
	4. 模块基板粘接: 胶水☐ 胶膜☐	导电?☐ 绝缘?☐ 高导热绝缘?☐
	5. 封装与罐封	绑线顶部球形封装?☐ 顶部封装带围坝?☐ 多元件灌封? ☐
	6. 热界面酯膏	酯?☐ 胶体成型酯?☐ 导电酯?☐ 导热胶水?☐
	7. 热界面胶片-胶带-薄膜	可压缩相变?☐ 间隙填充片?☐ 压敏导热片?☐ 干膜?☐
	8. 绝缘金属基板	标准绝缘铜铝基板?☐ 绝缘铜铜基板☐ 柔性绝缘金属基板?☐
	9. 柔性印刷电路基板 单面☐ 双面☐	绝缘层厚度: 铜薄层厚度: 1oz?☐ 1/2oz?☐ 1/4oz?☐
	10.盖板密封: 胶水☐ 胶膜☐	机械半气密?☐ 机械 EMI 屏蔽?☐
	11.涂料（防潮防水）	透明 UV 阻隔?☐ 有色 UV 阻隔?☐ PWB 保形涂敷?☐ EMI 屏蔽?☐
	12. 密封剂（防潮防水）	柔性绝缘?☐ 坚固刚性绝缘?☐ 柔性 EMI 屏蔽?☐
	13. 划片胶带	直接撕除解片?☐ UV 解片?☐ 热解片?☐
	14.磨片胶带(用于晶片或基板磨薄)	平面晶圆或基板?☐ 带金球晶圆?☐ 带焊锡球晶圆? ☐
	15.晶片磨片临时粘合"蜡"	旋涂 IPA 液体?☐ 可溶 IPA 薄膜?☐ 厚度:
	16. 特定和特殊应用需求	
	III. 点胶	*请检查并尽可能地提供细节*
	1. 针管针头点胶	☐ 压力时间控制，针头规格: ☐ 体积流量控制， 针头规格
	2. 丝印 ☐ **钢网印刷** ☐	☐ 钢网或丝印厚度:
	• **理想粘度和触变性**	粘度(cps) @5 rpm: 触变系数范围:
	3. 胶膜 (预切-片状-卷装)	干膜?☐ 粘性 PSA?☐ 胶膜的长宽厚：:

IV. 粘接固化条件**:** *(请尽可能精确)*

最高固化温度: °C ☐ or °F ☐	最长固化时间: Min ☐ or Hr. ☐
最大压力 (仅用于胶膜): psi (or other unit)	需全程夹具固定固化?☐ 轻触熔流后无压力固化?☐

V. 可靠性和技术方面的考虑**:**

➢ **粘合或界面面积** (应力的考虑)	宽度: 长度: 直径	面积(如 0.5cmx 2.0cm)
➢ **被粘材料** (热膨胀系数的考虑)	元件材料: 基板材料:	材料(如 铝，铜，FR4)
➢ **平面度公差** (厚度的考虑)	宽度方向: 长度方向:	如. 6mils total or 2mil/inch, 等等.
➢ **电绝缘或导电**	绝缘: 导电:	电阻率Ω-cm, 绝缘强度 V/mil
➢ **设备功率** (热界面的考虑)	瓦特:	瓦特(如 30 瓦)
➢ **最高工作温度**	摄氏度:	如 80ºC, 150ºC, 250ºC
➢ **最高瞬时温度**	摄氏度: 持续时间:	如 250ºC wire-bonding, 350ºC for 5 minutes
➢ **最高温度及负载** (胶剂的玻璃化温度的考虑)	最高温度(ºC): 拉伸剪切载荷 (psi):	如 125ºC, 125psi, tensile and/or shear load
➢ **温度循环** (应力的考虑)	最低温 ºC: 最高温 ºC: 循环次数:	如. –40ºC/85ºC, –55ºC/150ºC for 1000 cycles
➢ **其他**	NASA 释气☐ 军标 883D/5011.2 ☐ HAST☐	其他:

VI. 使用量 (每年):

VII. 需要日期: 试用期:_____ 生产期:_____

说明**:**

Please fax (609) 799-9308 or email:ait@aitechnology.com the completed form to AiT. Call (609) 799-9388 for additional questions or assistance.